



平成 19 年 11 月 15 日

各 位

会 社 名 **ネツレン**
高周波熱錬株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山下 英 治
(コード番号 5976 東証第 1 部)
問 合 せ 先 専務取締役管理本部長
砂 古 豊 幸
(TEL. 03 - 3443 - 5441)

子会社の清算に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 11 月 15 日開催の当社取締役会において、下記の子会社を清算することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 会社の概要

- (1) 会 社 名 PAKAM REBANA SDN. BHD.
- (2) 所 在 地 2-1, Jalan Vivekananda, Brickfields, 50470, Kuala Lumpur. (マレーシア)
- (3) 代 表 者 名 山下 英 治、Hussain Bin Khamis
- (4) 事 業 内 容 持株会社
- (5) 設 立 年 月 日 平成 4 年 3 月
- (6) 資 本 金 50 万 RM (マレーシアリンギット)
- (7) 株 主 高周波熱錬株式会社 99.99%

2. 清算の理由

PAKAM REBANA SDN. BHD. (以下「パカム社」) は、平成 4 年 3 月に設立され、マレーシアにおける当社持株会社として、当社の主力製品である P C 鋼棒等の製造、販売目的の合弁事業に携わってまいりました。その後、当社が当該合弁事業から撤退したため、平成 12 年 8 月以降、同国において法的にのみ存在した状態となっておりました。

当社は、このたび、パカム社の同国における展開余地が当面ないものと判断し、今般、清算することといたしました。

3. 清算の日程

平成 20 年 3 月末 清算終了 (予定)

4. 業績予想への影響

本件による当社平成 20 年 3 月期業績への影響は軽微であります。なお、適時開示基準に該当する事象が発生した場合には、適時適切な開示をいたします。

以 上